

招待会社名 Invited by

電子機器2026

トータルソリューション展

2026.6.10 Wed. → 12 Fri. 10:00-17:00

東京ビッグサイト東展示棟・会議棟

完全WEB登録制 事前登録 パッと登録! パッと入場!

事前登録のうえ、来場者バッジを出力しお持ちいただいた方は、当日会場内設置のバッジホルダーをピックアップいただくだけでスムーズにご入場いただけます。

来場登録はこちらのWEBから
▶ www.jpccashow.com/

入場料: 1,000円 (税込) WEB登録にて無料

招待状

www.jpccashow.com



事前来場登録のご案内

電子機器トータルソリューション展はWEB登録制となります。事前にWEBにて登録をお願いいたします。本招待状のみでは入場できませんのでご注意ください。

STEP.1

公式ホームページより来場登録へお進みください。


STEP.2

ご登録いただいたメールアドレス宛にログインIDが記載されております。(パスワードは登録時に設定されたものになります) ログイン後、バッジの発行やセミナー登録にすんでください。

STEP.3

展示会当日、来場者マイページより来場者バッジをプリントアウトし、四つ折りの状態でご持参ください。バッジホルダーをピックアップいただき、来場者バッジを中に入れ、会場入口にてバーコードをご提示ください。

事前登録/最新情報はHPをご覧ください



開催概要



JPCA Show 2026
第55回国際電子回路産業展



JIEP 2026
マイクロエレクトロニクス
第40回 最先端実装技術・パッケージング展



JISSO PROTEC 2026
第27回 実装プロセステクノロジー展



AI Device Expo
AIデバイス展



WIRE Japan Show 2026
ワイヤレス技術展



Electronics Component & Unit Show
電子部品・ユニット技術展



E-Textile/Wearable
電子繊維・ウェアラブル技術展



半導体産業展



OSAT
OSAT技術展

来場者参加型企画

ブースコンテスト

ブースコンテストを今年も開催! イクスデザイン賞・特別賞が皆様の投票で決定します。

展示会オリエンテーション&ツアー

学生の皆様に向け、オリエンテーションを開催し、終了後ツアーを実施します。



JPCA賞 (アワード)

優れた製品・技術内容や、新製品・新技術を促進させて展示会に活力を与え、総合的な技術の進歩発展を図っている出展者を表彰します。

6月10日(水) 16:40~17:00
東7ホール セミナー会場7



半導体オプ・ザ・イヤー2026 受賞製品・技術発表

6月10日(水) 14:00~(受付開始13:30~)
東7ホール セミナー会場10



アカデミックプラザ表彰式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP 展示会委員会で優秀な論文内容を選考し、アカデミックプラザ賞受賞者を決定いたします。

6月10日(水) 16:40~17:00
東7ホール セミナー会場9

電子機器トータルソリューション展 基調講演 無料 事前登録

東7ホール 基調講演会場

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>10:30-11:20</p> <p>半導体産業は2030年に200兆円の巨大市場を構築する! ~AIインフラの浸透と、後工程・基板が重要ななる展開</p> <p>東産業タイムズ社 取締役会長 奥野 浩</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>通信と情報処理に革新をもたらすIOWN構想とそれを支える光電融合デバイス技術</p> <p>NTT 先端集積デバイス研究所 所長 竹ノ内 弘和</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>日本の実装技術で、世界をつなぐ</p> <p>川島 知浩 (株)アムコー・テクノロジー・ジャパン 代表取締役社長 兼 日本統括責任者</p>
<p>11:30-12:20</p> <p>AI時代を支えるフラッシュメモリ戦略と次世代製造</p> <p>キオクシア若手代表 代表取締役社長 柴山 耕一郎</p>	<p>11:30-12:20</p> <p>2030年に向けて加速度的に拡大する半導体市場、AI投資は継続するの?</p> <p>先導パナソニックの技術開発と応用市場</p> <p>南川 明 アイエ電子 先導パッケージング推進本部 取締役</p>	<p>11:30-12:20</p> <p>特別講演 PCB産業の動向 - 日本企業のとるべき道</p> <p>Dr. Hayao Nakahara N.T. Information, Ltd. CEO</p>

JISSO PROTEC 特別講演 無料 事前登録

東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>10:30-11:20</p> <p>スマートフォン・周辺機器、Apple製品、AIサーバーの業界見通し</p> <p>中根 康夫 みずほ証券 上級アナリスト グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ・シニアアナリスト</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>規格カイゼン提案による電子部品の品質向上への取組み</p> <p>西森 久雄 トヨタ自動車 電子性能開発部 電子性能開発室グループ長</p>	<p>10:30-11:20</p> <p>2026年度版 JEITA 実装技術ロードマップの紹介 ~実装設備の最新動向~</p> <p>前田 憲 パナソニック コネクト 回路形成プロセス事業部 主任技術者 回路形成プロセス事業部 主任技術者 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) JEITA Jisso 技術ロードマップ専門委員会 実装設備 WG 主席</p>

半導体産業展 特別講演 無料 事前登録

東7ホール 半導体産業展特別講演会場

6月11日(木)	6月12日(金)
<p>13:00-13:50</p> <p>半導体政策に見る日本経済復活の道筋</p> <p>甘利 明 自由民主党 元幹事長 / 自由民主党 半導体戦略推進議員連盟 名誉会長</p>	<p>13:00-13:50</p> <p>九州半導体の現在と産業界 (SIIQ) の取り組み</p> <p>山口 宣洋 (一社) 九州半導体デジタル・イノベーション協議会 会長</p>
<p>14:20-15:10</p> <p>半導体の世紀</p> <p>黒田 忠広 東京大学 特別教授 / 熊本県立大学 理事長</p>	<p>14:20-15:10</p> <p>半導体産業における最新トピックス</p> <p>真志 隆博 (同) デロイトトーマツ パートナー / 熊本半導体ビジネス室 室長</p>
<p>15:40-16:30</p> <p>日本の半導体産業の将来に向けて</p> <p>経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体部 部長 前原 誠</p>	<p>15:40-16:30</p> <p>半導体産業の経営戦略を探る</p> <p>大山 聡 株式会社 代表</p>

PROTEC セミナー 無料 事前登録不要

※各社の申し込み方法に準じます

東1ホール PROTEC セミナー会場

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>11:45-12:30</p> <p>光電融合・先端PKG実装を切り拓く精密液体制御技術</p> <p>久保 尚 武蔵エンジニアリング 営業 統括課長</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>コンパクトという選択 - 新実装機 CLT-FG</p> <p>西山 龍 株式会社 ロボットソリューション事業部 第2設計課 課長</p>	<p>11:45-12:30</p> <p>実装境界ゼロ始動 - 世界初! 016008実装、その本質は「あらゆる実装品質の証明」にある</p> <p>武野 祐丸 株式会社 ロボットソリューション事業部 マーケティング部 プロダクトマーケティング課 マーケティングアドバイザー/エンジニア</p>
<p>12:55-13:40</p> <p>一自律生産の実現を目指す Fujii Smart Factory の進化</p> <p>加藤 大輔 株式会社 ロボットソリューション事業部 スマートファクトリー開発部 部長</p>	<p>12:55-13:40</p> <p>SMT検査工程の省人化を実現する最新AI活用ソリューション</p> <p>河合 秀幸 ヤマハ発動機 ロボティクス事業部技術統括部 SMT 第1開発部 部長</p>	<p>12:55-13:40</p> <p>実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法</p> <p>実安 祐介 パナソニック コネクト 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト プロジェクトリーダー</p>
<p>14:05-14:50</p> <p>実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法</p> <p>実安 祐介 パナソニック コネクト 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト プロジェクトリーダー</p>	<p>14:05-14:50</p> <p>【事例から読み解く】部品挿入工程の自動化と技術ポイント</p> <p>若林 利昌 株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア</p>	<p>14:05-14:50</p> <p>実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026</p> <p>若林 利昌 株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア</p>
<p>15:15-16:00</p> <p>実務で役立つクリームはんだ印刷技術2026</p> <p>若林 利昌 株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT 営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア</p>	<p>15:15-16:00</p> <p>実装工程の品質を飛躍的に向上! 最新はんだ印刷技術の基礎と実践の最適手法</p> <p>実安 祐介 パナソニック コネクト 回路形成プロセス事業部 プロダクト開発センター 機構開発部 機構プラットフォーム開発課 印刷機プロダクト プロジェクトリーダー</p>	<p>15:15-16:00</p> <p>パワー半導体分野における実装技術トレンド</p> <p>早川 めぐみ 千住金属工業 研究開発本部 ハンダテクノロジセンター 研究員</p>

JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料 事前登録

会議棟6F 最先端実装技術シンポジウム A会場・B会場

聴講するには事前登録のうえ、聴講料の支払いが必要です (VIP登録された場合も有ります)。会場区分によって聴講料が異なります。詳細・登録はHPよりご確認ください。

A会場 (会議棟605・606)	B会場 (会議棟607・608)
<p>10:00-10:50</p> <p>10A15 Beyond5Gに向けた高速通信用途向け基板材料の開発動向</p> <p>広川 祐樹 パナソニック イングストリー 電子材料事業部 電子材料BU 技術一課 課長</p>	<p>10:00-10:50</p> <p>10B11 光電融合パッケージ基板の最新動向</p> <p>天野 健 産業技術総合研究所 光電融合研究センター 研究センター長</p>
<p>10:50-11:40</p> <p>10A12 Beyond5G向け低伝送損失/低熱膨張基板材料の開発動向</p> <p>谷川 隆雄 株式会社 エレクトロニクス事業本部 開発センター 機構材料開発部 チームリーダー</p>	<p>10:50-11:40</p> <p>10B12 加速する光化 Co-Packaged Optics の最新動向と実装技術</p> <p>大石 京三 株式会社 研究開発本部 フォトリソグラフィ事業部 開発部 係責任者</p>
<p>11:40-12:30</p> <p>10A18 最新 PTFE 多層 PCBソリューションと超低 Dk・Df の PTFE 低損失材料</p> <p>興長 剛 株式会社 PILLAR プロセス部 基板技術グループ 課長</p>	<p>11:40-12:30</p> <p>10B13 高性能で高効率な次世代 AIファクトリーを実現するための最先端実装技術とその効果</p> <p>興野 浩史 エスエスエー株式会社 エンタープライズマーケティング シニアマーケティングマネージャー</p>
<p>13:00-13:50</p> <p>10A-2 高周波・高速伝送を支える先端配線板とモジュール</p> <p>産長: 谷 元昭、佐藤 牧子</p>	<p>13:00-13:50</p> <p>10B-2 半導体の経営戦略を探る</p> <p>産長: 土門 孝彰、森川 泰宏</p>
<p>13:30-14:20</p> <p>10A21 光に切り替わる AI時代のプリント配線板と必要とされる材料について</p> <p>飯長 裕 OKI ケーパードバイナリ 営業 統括部 マーケティング部 部長</p>	<p>13:30-14:20</p> <p>10B21 AIの急速な進化が、半導体の技術進化を加速させる</p> <p>山本 義雄 みずほ証券 上級アナリスト</p>
<p>14:20-15:10</p> <p>10A22 プリント配線板の技術動向と高周波・高速伝送に向けた取り組み</p> <p>戸田 光昭 株式会社 協賛設計開発室 室長</p>	<p>14:20-15:10</p> <p>10B22 衝撃の半導体市場・ダイナミズム・マーケティング・メトリクスで読み解く</p> <p>永田 隆一 アンカー・ビジネス・システムズ 代表取締役社長</p>
<p>15:10-16:00</p> <p>10A23 ミリ波帯アンテナ一体型モジュール技術と6Gに向けた取り組み</p> <p>上田 英樹 株式会社 通信事業部 通信システム事業部 無線技術開発部 パナソニック</p>	<p>15:10-16:00</p> <p>10B23 半導体の経営戦略を探る</p> <p>大山 聡 株式会社 代表</p>

ダントツものづくりセミナー 無料 事前登録不要

東7ホール セミナー会場8

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>13:00-13:45</p> <p>06101K 【特別基調講演】DX時代の地域スクール/JPCAものづくりアカデミー</p> <p>藤本 隆宏 早稲田大学ビジネス・フロンティアセンター 顧問・招請研究員</p>	<p>13:00-13:45</p> <p>0611T3 【特別講演3】電子回路ものづくり企業の実現する全体最適の働き方イノベーション</p> <p>岸原 裕司 ゴールドドラフト・ジャパン CEO</p>	<p>13:00-13:45</p> <p>0612T7 【特別講演7】電子回路ものづくり企業の「現場改善」について「お金の良い流れ」から考える</p> <p>終 兼乃 愛知工業大学経営学部経営学科 教授</p>
<p>13:45-14:30</p> <p>06101K 【特別基調講演】電子回路ものづくり業界、人手不足、原材料高騰の中での電子回路業界活性化は生産性向上しかない!</p> <p>藤本 隆宏 早稲田大学ビジネス・フロンティアセンター 顧問・招請研究員</p>	<p>13:45-14:30</p> <p>0611T4 【特別講演4】月曜日が楽しいみな会社にしよ! ~全体最適のマネジメント理論 TOCとは~</p> <p>岸原 裕司 ゴールドドラフト・ジャパン CEO</p>	<p>13:45-14:30</p> <p>0612T8 【特別講演8】経営者は何を管理すれば現場改善効果を見える化できるのか【現場改善大会】(KCC)</p> <p>終 兼乃 愛知工業大学経営学部経営学科 教授</p>
<p>14:35-15:20</p> <p>06101T 【特別講演1】2026年後半の日本経済・産業</p> <p>鍋山 徹 一般社団法人 日本経済研究所 コンサルティングフェロー</p>	<p>14:35-15:20</p> <p>0611T5 【特別講演5】トヨタ式現場管理</p> <p>田中 正和 トヨタ自動車 OB ものづくり大学名誉教授 / J-コスト研究センター 代表</p>	<p>14:35-15:20</p> <p>0612T9 JPCAものづくり大賞/準大賞受賞 (2024年度) 改善取組事例報告4件 準大賞受賞: FICT 長野本社工場 京浜 三和電子 岡山本社工場 株式会社 本社工場</p> <p>山本 治彦 JPCA ものづくりアカデミー 校長 / JPCA 顧問 - ES&MAP 研究会 特別顧問</p>
<p>15:20-16:05</p> <p>06101T 【特別講演2】2027年の経済・産業展望</p> <p>鍋山 徹 一般社団法人 日本経済研究所 コンサルティングフェロー</p>	<p>15:20-16:05</p> <p>0611T6 【特別講演6】現場改善のJ-コスト理論による強化策 (ROA)</p> <p>田中 正和 トヨタ自動車 OB ものづくり大学名誉教授 / J-コスト研究センター 代表</p>	<p>15:20-16:05</p> <p>0612T0 【基調講演】人的資本を最大化するトヨタ方式「育ち抜く」戦略 新人教育「もつくり改善」出版・開講協力</p> <p>山本 治彦 JPCA ものづくりアカデミー 校長 / JPCA 顧問 - ES&MAP 研究会 特別顧問</p>

PWB コンサルタントによるセミナー 有料 事前登録

会議棟609

詳細・登録はHPよりご確認ください。各プログラム毎のお申込み (先着順定期) となります。

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>11:00-12:00</p> <p>12A11 多層リジッドプリント配線板の製造方法 初級~中級編</p> <p>一色 和隆 株式会社 技術 代表取締役社長 (JPCA認定PWBコンサルタント)</p>	<p>11:00-12:00</p> <p>12B11 プリント配線板の品質・製造技術 ~こまごとの解決に向けて①回路形成~</p> <p>渡辺 正 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>11:00-12:00</p> <p>12C11 プリント配線板の品質・製造技術 ~こまごとの解決に向けて②印刷~</p> <p>一色 和隆 株式会社 技術 代表取締役社長 (JPCA認定PWBコンサルタント)</p>
<p>12:30-13:30</p> <p>12A12 基板の環境対応について技術営業セミナー</p> <p>中山 務 富士プリント工業 (JPCA認定PWBコンサルタント)</p>	<p>12:30-13:30</p> <p>12B12 プリント配線板のめっき技術 ~無電解めっきと電気めっきの基礎~</p> <p>渡辺 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>12:30-13:30</p> <p>12C12 プリント配線板のめっき技術 ~無電解めっきと電気めっきの基礎~</p> <p>渡辺 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント</p>
<p>14:00-15:00</p> <p>12A13 プリント配線板における要素技術 初級編</p> <p>渡辺 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>14:00-15:00</p> <p>12B13 プリント配線板のめっき技術 ~無電解めっきと電気めっきの基礎~</p> <p>渡辺 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>14:00-15:00</p> <p>12C13 プリント配線板のめっき技術 ~無電解めっきと電気めっきの基礎~</p> <p>渡辺 喜夫 JPCA認定PWBコンサルタント</p>
<p>15:30-16:30</p> <p>12A14 プリント配線板の品質保証 初級~中級編</p> <p>保坂 三喜雄 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>15:30-16:30</p> <p>12B14 セットメーカー向け ~あとから困らないプリント配線板の調達~</p> <p>伊藤 直樹 JPCA認定PWBコンサルタント</p>	<p>15:30-16:30</p> <p>12C14 プリント配線板の品質保証 初級~中級編</p> <p>保坂 三喜雄 JPCA認定PWBコンサルタント</p>

JIEP アカデミックプラザ 無料 事前登録不要

東7ホール セミナー会場9

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>13:00-13:20</p> <p>13A11 低温ヘテロジニアス集積のためのAu薄膜転写を応用した接合面の平滑化およびマイクロパターンの研究</p> <p>後藤 慎太郎 東北大学大学院工学研究科</p>	<p>13:00-13:20</p> <p>13B11 左右ボーンレス加工パラメータ最適化を有する穴あけ加工機によるプリント基板のマイクロドリル加工におけるサイクルタイム短縮の検討</p> <p>結城 要 同志社大学大学院</p>	<p>13:00-13:20</p> <p>13C11 ソフト3D エレクトロニクス技術により試作した光るクラグ</p> <p>加藤 空 国立大学 山形大学 大学院 有機材料システム研究科</p>
<p>13:20-13:40</p> <p>13A12 USB2.0通信の電磁的情報漏洩実験の構築と盗聴防止を目的とした漏洩メカニズムの解明</p> <p>川井 拓真 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科</p>	<p>13:20-13:40</p> <p>13B12 マイクロドリル加工の多目的最適化におけるランダムフォレストを用いた刃先摩耗と穴形状精度の同時予測</p> <p>藤多 尚 同志社大学</p>	<p>13:20-13:40</p> <p>13C12 デザイン思考による見た目の形状変化を活用したPOPディスプレイシステムの開発</p> <p>阪本 邦夫 甲南大学</p>
<p>14:00-14:20</p> <p>14A11 回路ハードウェアに対する深層学習サイドチャネル攻撃耐性評価の効率化に向けた検討</p> <p>中村 幸成 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科</p>	<p>14:00-14:20</p> <p>14B11 サイドチャネル攻撃対策AES暗号のFPGA実装と深層学習攻撃耐性の評価</p> <p>光澤 裕 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科</p>	<p>14:00-14:20</p> <p>14C11 医用連携に基づく手術支援ロボットの開発</p> <p>竹内 洸人 日本大学</p>
<p>14:20-14:40</p> <p>14A12 ITO薄膜を用いた第6世代移動通信システム用GHz帯透明電磁シールドの検討</p> <p>佐藤 潤 東京工科大学</p>	<p>14:20-14:40</p> <p>14B12 ITO薄膜を用いた第6世代移動通信システム用GHz帯透明電磁シールドの検討</p> <p>佐藤 潤 東京工科大学</p>	<p>14:20-14:40</p> <p>14C12 半導体産業に向けた低温焼成接合を可能とする銅ナノ粒子系</p> <p>米澤 暁 北海道大学 大学院工学研究科 米澤研究室</p>
<p>15:00-15:20</p> <p>15A11 基板端部に給電点に配置したITO透明広帯域アンテナの放射素子形状に対する放射効率の検討</p> <p>高橋 希望 東京工科大学大学院 工学研究科</p>	<p>15:00-15:20</p> <p>15B11 動的パーコレーション誘導を用いた3D印刷配線の低抵抗化に対するバインダ化学的役割</p> <p>井上 健博 国立大学法人 群馬大学</p>	<p>15:00-15:20</p> <p>15C11 水平台機構と光を用いた鳥類回避システム</p> <p>山田 龍 筑城大学大学院 工学研究科 機械工学専攻</p>
<p>15:20-15:40</p> <p>15A12 子どもと高齢者を対象とする見守りのためのドアノブ電極とウェアラブル機器の間の人体通信の検討</p> <p>橋本 友 東京工科大学大学院 工学研究科</p>	<p>15:20-15:40</p> <p>15B12 銅系導電ペーストの材料設計による金属電極界面の電気接続安定化</p> <p>内田 歩 群馬大学大学院 群馬大学</p>	<p>15:20-15:40</p> <p>15C12 スイッチング電源など閉回路の導線内循環電流について</p> <p>宝本 孝大 信州大学 工学部 工学科 電気電子コース 高効率電力システム 部 部長研究室</p>
<p>16:00-16:20</p> <p>16A11 金属製配線架利用時の人体通信における伝送特性劣化低減の検討</p> <p>山下 幹人 東京工科大学大学院</p>	<p>16:00-16:20</p> <p>16B11 ストレッチャブル印刷配線の信頼性向上に向けたバインダ分子設計と抵抗率安定化</p> <p>岡村 春彦 国立大学法人 群馬大学</p>	<p>16:00-16:20</p> <p>16C11 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>
<p>16:20-16:40</p> <p>16A12 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>	<p>16:20-16:40</p> <p>16B12 液体金属配線 - 印刷電極界面の反応挙動と接続抵抗の安定性評価: ストレッチャブル回路構築に向けて</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>	<p>16:20-16:40</p> <p>16C12 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>
<p>16:40-17:00</p> <p>16A13 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>	<p>16:40-17:00</p> <p>16B13 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>	<p>16:40-17:00</p> <p>16C13 マルチマテリアル印刷配線に向けた低伝導率材料の活用</p> <p>羽鳥 統希 群馬大学</p>

ぶりとんぱんじゅくセミナー 無料 事前登録不要

東1ホール セミナー会場7


6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>13A11 プリント配線板全般の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>堀場 正男 株式会社 パオファス 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>13B11 プリント配線板全般の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>堀場 正男 株式会社 パオファス 代表取締役</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>13C11 プリント配線板全般の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>堀場 正男 株式会社 パオファス 代表取締役</p>
<p>14:15-15:15</p> <p>14A11 フレキシブル配線板の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>宮崎 博明 元M/Fインフォメーション 代表</p>	<p>14:15-15:15</p> <p>14B11 フレキシブル配線板の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>宮崎 博明 元M/Fインフォメーション 代表</p>	<p>14:15-15:15</p> <p>14C11 フレキシブル配線板の基礎「ぶりとんぱんじゅく」をもとに解説</p> <p>宮崎 博明 元M/Fインフォメーション 代表</p>

化学物質伝達ツール解説セミナー 無料 事前登録不要

東1ホール JISSO PROTEC 特別講演会場

6月10日(水)	6月11日(木)	6月12日(金)
<p>13:00-14:00</p> <p>13A11 CMPの全体解説と今秋適用開始に向けて</p> <p>森 伸明 CMP 仕様検討委員会 委員長・CMP コンソーシアム</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>13B11 CMPの全体解説と今秋適用開始に向けて</p> <p>森 伸明 CMP 仕様検討委員会 委員長・CMP コンソーシアム</p>	<p>13:00-14:00</p> <p>13C11 CMPの全体解説と今秋適用開始に向けて</p> <p>森 伸明 CMP 仕様検討委員会 委員長・CMP コンソーシアム</p>
<p>15:00-16:00</p> <p>15A11 自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説</p> <p>藤本 智之 (一社) 日本電子回路工業会 参事</p>	<p>15:00-16:00</p> <p>15B11 自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説</p> <p>藤本 智之 (一社) 日本電子回路工業会 参事</p>	<p>15:00-16:00</p> <p>15C11 自動車向け化学物質伝達ツールIMDS活用の概説</p> <p>藤本 智之 (一社) 日本電子回路工業会 参事</p>

あなたの足、ちゃんと踏ん張れますか?
転倒予防の指標「足指力」を30秒で測定! 結果判定やトレーニングもできる体験型ツール HAJI-CHECK (HAJIチェック) をぜひお試しください。
技術提供: 横二コ



※本招待状に掲載のプログラム他は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にご協力をお願いいたします。

出展者 (NPI) プレゼンテーション 無料 事前登録不要 ※一部、要事前登録の可能性がございます。 東1・3・7ホール セミナー会場

Table with 4 columns: 東1ホール セミナー会場 4, 東3ホール セミナー会場 5, 東7ホール セミナー会場 10, 東3ホール セミナー会場 6 (クロス). Each column lists time slots and topics related to semiconductor technology, such as AI integration, packaging, and materials.

主催者企画・光電融合セミナー・展示 (特別協力: 傑オプトロニクス社) 無料 事前登録不要 東7ホール 特設会場

Table for the special event featuring a presentation on AI and optical integration. Topics include AI for optical inspection and high-speed production of optical components.

他ではセッタイ聞けない「主催者セミナー」 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場11

Table for the exclusive seminar featuring a presentation on AI and optical integration. Topics include AI for optical inspection and high-speed production of optical components.

出展者 (NPI) プレゼンテーション (eX-tech) 無料 事前登録不要 東3・7ホール セミナー会場

Table with 2 columns: 6月10日 (水), 6月11日 (木), 6月12日 (金). Lists various semiconductor technology presentations and seminars.

3D-MID パビリオンセミナー 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場9

Table with 2 columns: 6月10日 (水), 6月11日 (木), 6月12日 (金). Focuses on 3D-MID technology presentations and seminars.

半導体産業展 専門セミナー 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場12

Table for the semiconductor industry exhibition featuring specialized seminars on topics like AI and semiconductor materials.

スポンサー企業一覧

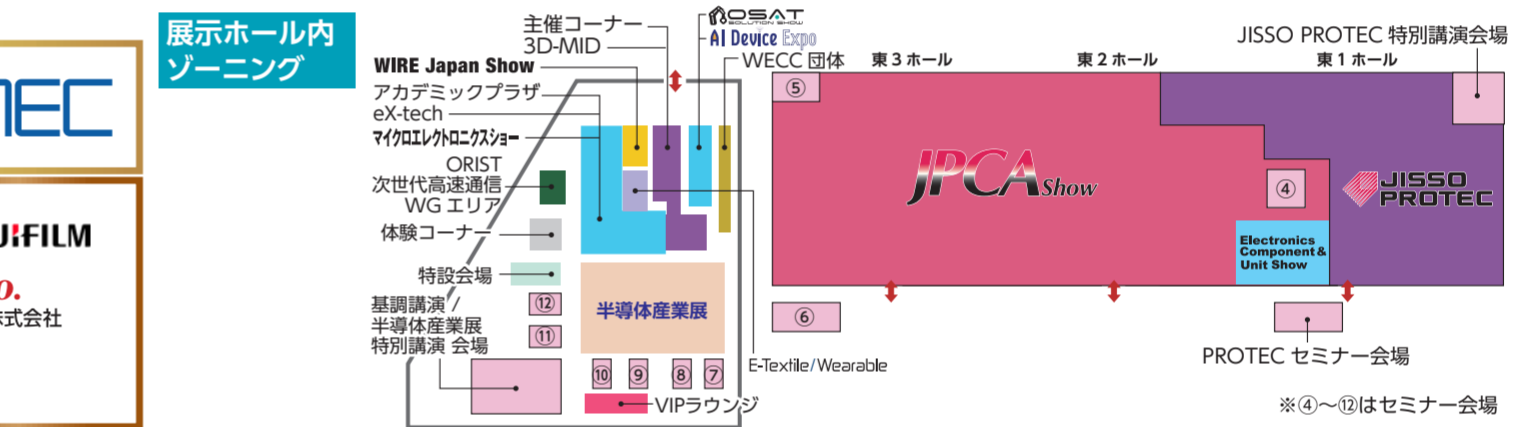
Advertisement banner for the event featuring logos of major sponsors such as MEIKO, V-TECHNOLOGY, mks, Atotech, ESI, Dynatron, and others.

E-Textile/Wearable展セミナー 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー E-Textile/Wearable展 (ブース内)

Table for the E-Textile/Wearable exhibition seminar, including presentations on smart textiles and wearable devices.

ORIST 次世代高速セミナー 無料 事前登録不要 東7ホール セミナー会場主催者企画セミナー ORIST展 (ブース内)

Table for the ORIST seminar, featuring presentations on next-generation high-speed technologies and materials.



出展者一覧

Large table listing exhibitors under the JPCA Show banner, categorized by industry sectors like domestic, overseas, and materials.

2026年5月1日 (金) 現在 (展示会別・50音順・法人格省略)

Large table listing exhibitors under the AI Device Expo, WIRE Japan Show, and JISSO PROTEC banners, categorized by industry sectors.

※本招待状に掲載のプログラム他は、変更となる場合がございます。予めご了承ください。講演当日は早めの受付にご協力をお願いいたします。